

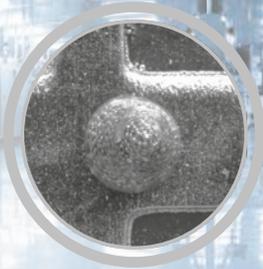
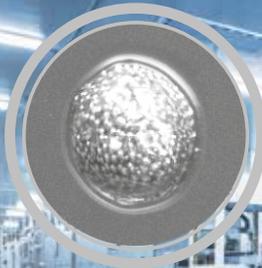
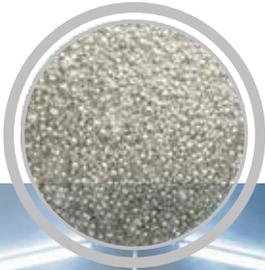
MDS 1560 - MICRO DISPENSING SYSTEM

FOR OPTIMAL SOLDER PASTE RESULTS

VERMES

••••• MICRODISPENSING

POWERED BY DST
DYNAMIC SHOCKWAVE TECHNOLOGY



솔더
페이스트
디스펜싱
시스템

고유한 DYNAMIC SHOCKWAVE TECHNOLOGY를 기반으로 한 솔더 페이스트 디스펜싱

DST- Dynamic Shockwave Technology로 구동되는 MDS1560으로 VERMES Microdispensing은 솔더 페이스트 Type 3부터 최소의 드롭사이즈에서도 최적의 결과를 안정적으로 디스펜싱 할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

VERMES Microdispensing System MDS 1560은 다양한 공급업체들의 솔더 페이스트 디스펜싱이 가능하며, 자동화된 디스펜싱 로봇과 같은 다양한 플랫폼에 쉽게 통합될 수 있습니다.

korea@vermes.com | www.vermes.com

고유한 기술을 통한
최고의 정밀도 및
프로세스 안정성 지원

SOLDER PASTE DISPENSING
WITH MICRO DISPENSING SYSTEM MDS 1560



디스펜싱 경우:



모듈 패키징 —
패키지에
패키지 디스펜싱

- Solder Paste Type 7
- 180µm drop size



인쇄 회로 기판에
전자 부품 장착

- Solder Paste Type 6
- 220µm drop size



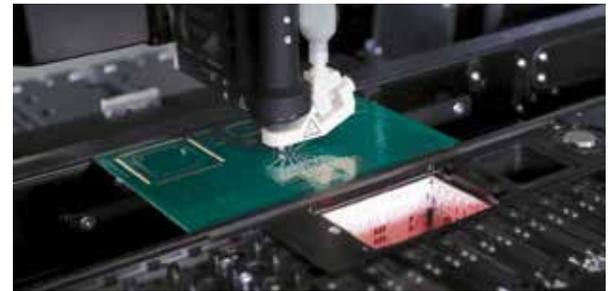
3 차원 성형
상호 연결 장치 생산

- Solder Paste Type 5
- 300µm drop size

VERMES Microdispensing Systems MDS 1560은 고객이 시스템의 다양한 혜택과 이점을 통합하여 최적의 솔더 페이스트 디스펜싱 결과를 얻는 데 도움을 줍니다.

예를 들어:

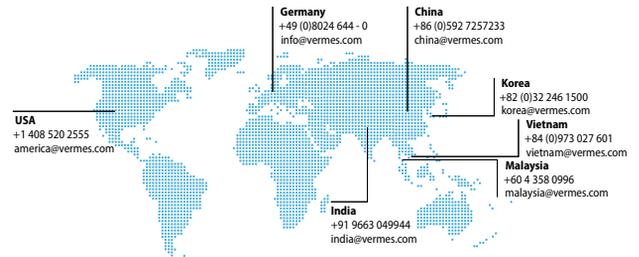
- DST-VERMES Microdispensing의 혁신적인 액추에이터 기술원리
- 최적화된 채널 가이드نس 및 압축구조의 구성
- 최소 스트로크에서도 뛰어난 파워, 정밀도 및 속도
- 용액을 일정 온도로 유지해 안정적인 점도를 가능케 하는 노즐 히팅 시스템



VERMES Microdispensing은 다양한 솔더 페이스트의 특성을 광범위하게 연구하고 있으며 고객의 어플리케이션에 맞는 최상의 솔루션을 제공하기 위해 시스템을 최적화하고 있습니다.

디스펜싱 용액의 개별 어플리케이션 테스트를 위해 문의
바랍니다.

korea@vermes.com



(주)버메스마이크로디스펜싱

부천시 평천로 655 부천테크노파크 403동 401호
14502 경기도, 대한민국

+ 82 (0) 32-246-1500 | korea@vermes.com | www.vermes.com